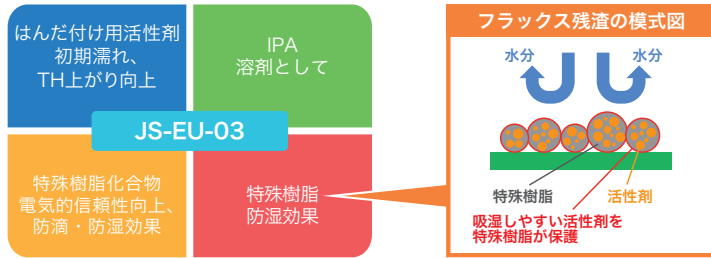


- 特殊樹脂の添加により、フラックス残渣の吸湿を防止し、低残渣性と信頼性の両立を実現します。
- フラックス残渣は無色透明で美観に優れベトつきがなく、ICT チェッカー性も良好です。

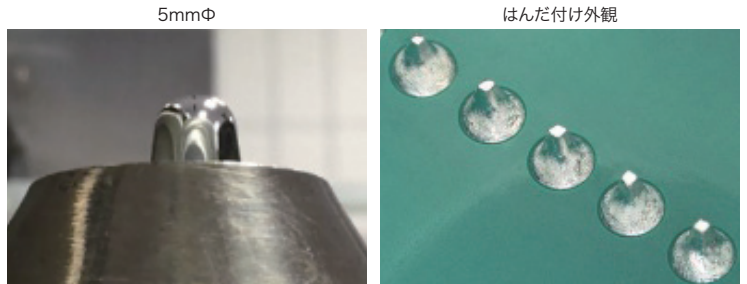
### マイグレーションの発生と防止メカニズム



はんだ付け後には、基板上有機酸の金属塩が存在しており、高温高湿度環境下、もしくは結露環境下に置くとその表面に水分が付着します。この水分に金属塩等のイオン成分が溶解し、電圧がかかることで、マイグレーションが発生します。JS-EU-03は、添加した特殊樹脂により、有機酸の金属塩等のイオン成分をコーティングし、イオン成分の水への溶解を防ぐことで、マイグレーションの発生を防止することができました。

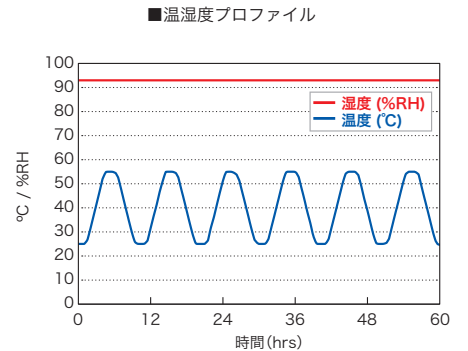
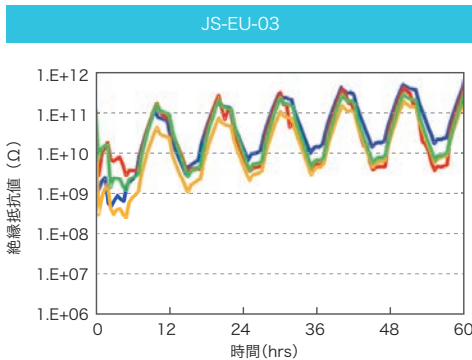
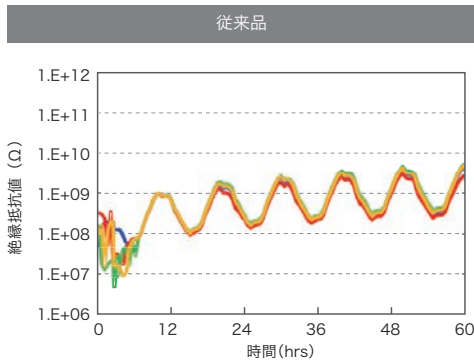
### 噴流はんだ付け

- はんだ温度：280°C
- 窒素温度：350°C
- ノズル形状：下図
- ノズル速度：3.0mm/sec
- 試験基板：PCB-A(t=1.6mm)

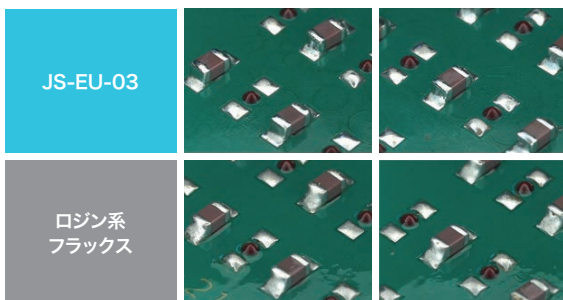


### 高い電氣的信頼性 結露サイクル試験

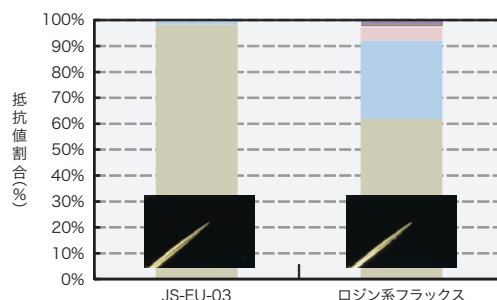
試験環境：25-55°C x 93±2%RH for 60 hours (6サイクル)  
塗布量：固形分膜厚1.2μm相当  
くし形電極基板：IPC-B-25 (Width: 0.318mm Distance: 0.318mm)  
印加電圧：DC50V  
測定電圧：DC50V



### きれいな外観、良好なピンコンタクト性



はんだ付け後の残渣量が少なくロジン系フラックスと比べ、べたつきが少ない



フラックスの付着が少なく、ピンコンタクト性が良好

- <0.2Ω
- 0.2<0.3Ω
- 0.3<0.4Ω
- 0.4<0.5Ω
- 0.5<0.6Ω
- 0.6<0.7Ω
- 0.7<0.8Ω
- 0.8<0.9Ω
- 0.9<1.0Ω
- 1.0Ω 以上
- 検出無し

項目	JS-EU-03
フラックスタイプ	ORLO
比重 (at 20°C)	0.798
不揮発残分 (%)	4.0
銅板腐食	L (IPC)
マイグレーション試験	Pass